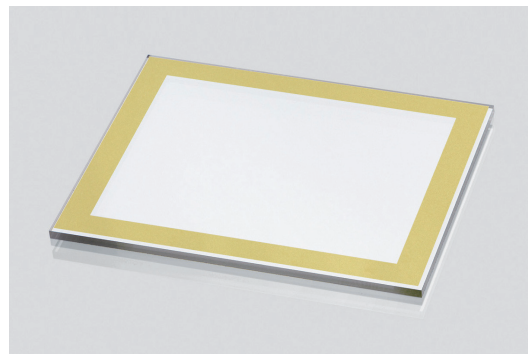


用于高级光学封装的图形化 Gelot™

可焊玻璃封装盖片

光敏半导体器件一般需要透明玻璃盖的封装。焊接是提供此类封装最佳气密性值的封装技术。Gelot™可焊镀膜技术使玻璃表面对金或钯等焊料具有良好的粘附性。Gelot™提供具有透光孔径的框架式光学封装盖片。



优点

- 提供玻璃与金属，玻璃与陶瓷的焊接
- 优异的气密性值
- 适用于高温应用
- 由于表面不腐蚀，具有优异的寿命
- 框架可用作光圈
- 允许清洁工艺
- 可支持晶圆级封装（WLP）

技术参数

最外层膜层	金
膜层厚度	300 nm
膜层的最小特征尺寸	20 μm
封装盖尺寸	最大 120 mm²
粘附力	>10 N/mm²
剪切强度	> 4 N/mm²

应用

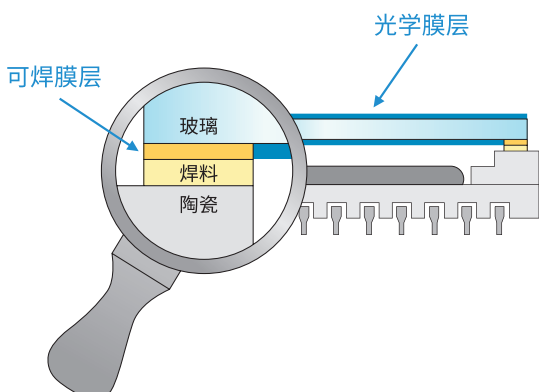
半导体器件的封装，如 CCD/CMOS，MEMS 传感器。

推荐

焊料预成型件 金 (Au)、钯 (Pd)
[避免使用铝 (Al)、锌 (Zn) 或镉 (Cd)]
在透光孔径上增加图形化增透膜 (AR)

焊接组件示意图

Gelot™ 镀膜为玻璃提供可焊表面。
焊料本身必须以预成型件的形式应用。



美题隆精密光学（上海）有限公司
上海浦东新区中国（上海）自由贸易区
富特东三路 76 号 33 号楼
邮编：200131

上海
电话：021 60574646
info.mbo@materion.com
www.materion.com/balzersoptics